

Transfer Molding System

Model Y1R1060



The origin of transfer molding system with modular concept

第一款采用模组方式的注塑成形设备

- 以多年实绩建立起来的高可靠性和稳定性好的注塑成形封装设备
- 合模压力为60吨
- 可通过增设或减少模组的方式灵活应对产能变化

产品信息



中文



SPECIFICATION

Items			Unit	Description			
机型			—	Y1R1060			
框架・基板类型			—	基板・引线框架			
框架・基板尺寸	长度		mm	100—260			
	宽度		mm	15—75			
树脂	径		mm	φ 13, 14, 16, 18, 20			
	长度		mm	14.3—35.0			
机械时间			sec	Approximately 20			
外形尺寸	模组数量		module	1	2	3	4
	堆叠式收料方式	宽度	mm	1,770	2,310	2,850	3,390
		纵深	mm	1,520	1,520	1,520	1,520
		高度	mm	1,800	1,800	1,800	1,800
	插片式收料方式	宽度	mm	1,770	2,310	2,850	3,390
		纵深	mm	1,860	1,860	1,860	1,860
		高度	mm	1,800	1,800	1,800	1,800
重量	堆叠式收料方式		ton	3.8	5.7	7.6	9.5
	插片式收料方式		ton	4.1	6.0	7.9	9.8
每模成形框架数量			workpiece	2	4	6	8
进料盒空间			mm	300			
出料盒数量 (堆叠式收料方式)			pcs	2			
出料盒空间 (插片式收料方式)			mm	300			
合模压力			kN／(tf)	196.0—588.0／20.0—60.0			
注塑压力			kN／(tf)	2.9—31.4／0.3—3.2 (2 step pressure setting)			
品种切换方式			—	采用KIT更换方式			
可以安装的模具			—	S, M, L			

- ・ 以上数据为本公司标准机型时的规格
- ・ 以上规格根据实际需要可能有改良变更的可能
- ・ 如有其他特殊规格要求，另行协商



东和半导体设备（上海）有限公司
中国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A
TEL 021-6888-6860

Website



Inquiry contact



TOWA（本公司商标），是TOWA株式会社的商标或注册商标。

Overseas Sales Contacts

Japan/Headquarters

TOWA Corporation

China

TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
TOWA Taiwan Co., Ltd.

Korea

TOWA Korea Co., Ltd.

Singapore

TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

Malaysia

TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

Philippines

TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.

Thailand

TOWA THAI COMPANY LIMITED

India

TOWA SEMICONDUCTOR INDIA
PRIVATE LIMITED

Germany

TOWA Europe GmbH

Netherlands

TOWA Europe B.V.

the United States

TOWA USA Corporation

20250401-004-HQ